

# 齒科用 合金 取扱에 대한 臨床的 考察

東山齒科技工所  
 蔣 漢 一

## Shrink Spot Porosity

clasp가 가  
 shrink spot porosity . sprueing 가  
 mold 가  
 가  
 가 가 sprue 가  
 mold 가  
 가  
 shrink spot porosity 가 sprue 가  
 가 가

## Overheating the Mold

Over heating mold  
 (coarse-grained)가  
 가  
 가  
 가  
 1300 mold dull red fluidy

## Sulphur Contamination

Gold alloy wire clasp  
 wire sulphur contamination  
 wire clasp가 가 가  
 가 (over  
 heated investment) (plaster of paris)  
 gypsum 가  
 calcium sulphur

sulphur compound  
base metal  
(metallicsulphides)

sulphur  
wire alloy

Paladium  
50%  
, zinc oxide  
가  
T set  
가

gold  
J.G

가  
wire  
wire  
Sulphur contamination  
clasp가  
350 가

wire

### Dangers in Soldering

Solder가  
solder가 metal

가  
Soldering  
wax

가

wax가

, 가

Wire clasp soldering  
가 wire가

가

가

가

가

flux

Wire gold gold alloy

solder가  
, high fusing solder low  
fusing solder가

### Base Metal Contamination

(mercury)

가

가

, pickling

가

Hot gold tweezers  
molten gold

가

가

Gold work bench

Pickling

가

Crucible linings asbestos

가

, wax

Inlay crowns band  
metal die

가

가

gypsum

가

(nitric acid)

pickling

			gas back pressure margin
		(burn out)	
가			dull red(
	가	1350 )	
wax		burn out	preliminary
		dull red	30
		inlay	
pickling			sprue
wax		wax가	가
	가		Wax가
pattern chamber		wax	
carbon monoxide gas			
가			